2026年11月10日

各　位

会 社 名　　株式会社ヨコオ
代表者名　　代表取締役兼執行役員社長　柳澤　勝平
（コード番号　6800　東証プライム市場）
問合せ先　　執行役員SCI本部長　多賀谷　敏久
（TEL. 03－3916－3111）

CTCセグメントにおける生産能力の追加増強投資に関するお知らせ

当社は、2026年11月10日開催の取締役会において、2026年6月19日付「CTCセグメントにおける生産能力増強に向けた投資に関するお知らせ」にて公表した投資計画（以下「既公表計画」といいます。）に加え、CTCセグメント（半導体検査関連事業）の生産能力をさらに増強するための追加投資を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．追加投資の目的及び背景

当社はCTCセグメントにおいて、微細精密加工技術・高周波技術等を駆使した半導体前工程検査用プローブカード／後工程検査用ソケット等を製造・販売する事業をグローバルに展開しております。近年、生成AI・データセンター及び高性能コンピューティング向け半導体の高度化に伴い、半導体検査においては、検査工程の増加、検査対象の複雑化及び高付加価値製品の需要拡大が進んでおります。当社は既公表計画に基づき、日本、マレーシア及びベトナムの各拠点において設備増強を進めておりますが、その後、既存顧客の需要拡大に加え、新規顧客及び新たな検査工程に係る引き合いが増加しており、既公表計画を上回る供給能力の確保が必要であると判断いたしました。

本追加投資は、既公表計画と同様、当事業のコア部品／コア製品であるコンタクトプローブ及びテストソケットの生産能力増強を目的とするものであり、ベトナム拠点を海外における生産中核拠点として一層強化するとともに、日本拠点の自動化及び生産・技術基盤の強化を図ることで、供給力の拡大と事業継続性の両立を図るものです。なお、生産設備については、市場・顧客動向及び生産性改善の進捗を確認しながら段階的に導入することにより、需要に即した機動的な投資を行ってまいります。

２．追加投資の概要

既公表計画では、マレーシア拠点への過度な生産機能の集中に伴うリスクを踏まえたBCPの観点から、ベトナム拠点を第二の海外生産中核拠点と位置づけ、生産機能の拡張を進めております。本追加投資では、ベトナム拠点における新工場の建設（第1新棟）を前倒しで進めるとともに、建屋の追加建設（第2新棟）を行い、各拠点の役割・生産配分の最適化を図りながら、生産能力を段階的に拡大してまいります。

既公表計画と今回の追加投資の対象及び内容は、次のとおりです。

区分	既公表計画（2026年6月19日公表）	今回の追加投資（2026年11月10日決議）
(1) 日本	建屋の増設、生産設備の新規導入	自動化及び生産・技術基盤の強化に係る関連設備の増強
(2) マレーシア	生産設備の新規導入	生産設備の新規導入
(3) ベトナム	土地の賃借、建屋の建設（第1新棟）、生産設備の新規導入	建屋の追加建設（第2新棟）、生産設備の段階的導入
投資総額	約81億円※（2031年3月期まで） ※開示当時は約76億円	約70億円（2031年3月期まで段階的に実施予定） 既公表計画との合計：約151億円

３．追加投資の金額及び時期

本追加投資の総額は、現時点で約70億円を見込んでおり、既公表計画の総額約81億円と合わせた投資総額は約151億円となる予定です。ベトナム拠点において第2新棟を建設するとともに、生産設備については、需要動向、生産性、歩留まり及び顧客・製品構成を定期的に検証したうえで、段階的に発注・導入を決定いたします。各新棟の建設については、需要動向及び許認可・建設工程等を踏まえ、第1新棟は2027年10月、第2新棟は2028年2月の竣工を予定しております。なお、所要資金は、自己資金及び借入金により充当する予定です。

４．今後の見通し

本追加投資が当期（2027年3月期）の連結業績に与える影響は軽微である一方、2028年3月期以降においてはCTCセグメントの売上高拡大が見込まれますが、具体的な見通しについては現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以　上